

# Soft X-ray Ionizer

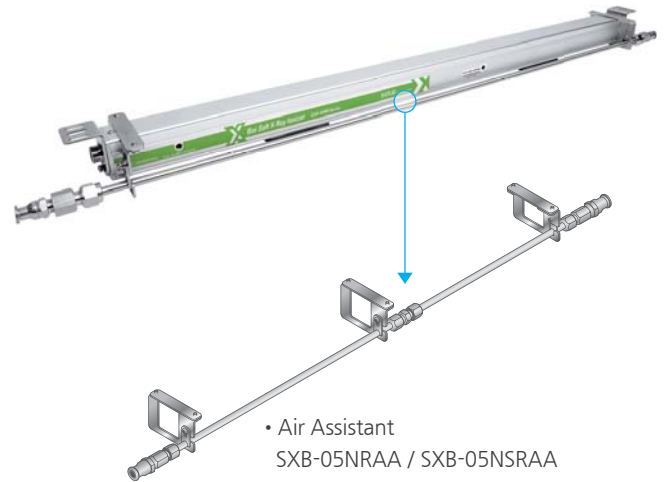
## Electrostatic Total Solution

### SXB-05NRAA / 05NSRAA

압축 공기 사용으로 빠른 제전 속도와 장거리 제전이 가능한 에어 어시스턴트입니다. 기존 Bar Type Soft X-ray Ionizer에 추가 장착하여 사용하며 에어 분사구의 설계를 최적화하여 고성능을 실현하였습니다.

### Key Features

- 압축 공기 사용으로 빠른 제전 속도와 장거리 제전이 가능한 에어어시스턴트
- 기존 제품에 추가(Optional) 장착 가능
- 고성능을 위한 에어 분사구의 최적화
- 부식 및 내구성이 뛰어난 SUS 재질 적용

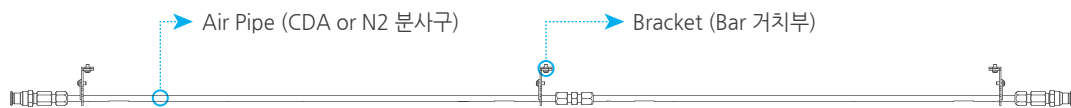


### Specifications

Parameter	Description / Value	Remarks
Air Purge Supply Pressure	0.1 ~ 0.5MPa	CDA (Clean Dry Air), N2
Material	SUS	
Warranty	1 year	

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### SXB-05NRAA / SXB-05NSRAA 구성



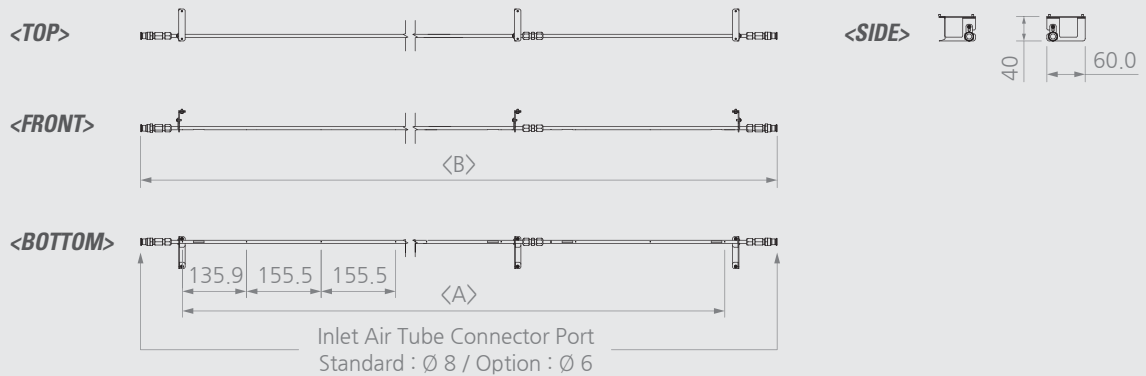
Model No.	Air Pipe	Bracket
SXB-05NRAA-300	1	2
SXB-05NRAA-600	1	2
SXB-05NRAA-900	2	3
SXB-05NRAA-1200	2	3
SXB-05NRAA-1500	3	4
SXB-05NRAA-1800	3	4
SXB-05NRAA-2200	4	5
SXB-05NRAA-2500	4	5
SXB-05NRAA-2800	5	6

# Soft X-ray Ionizer

## Electrostatic Total Solution

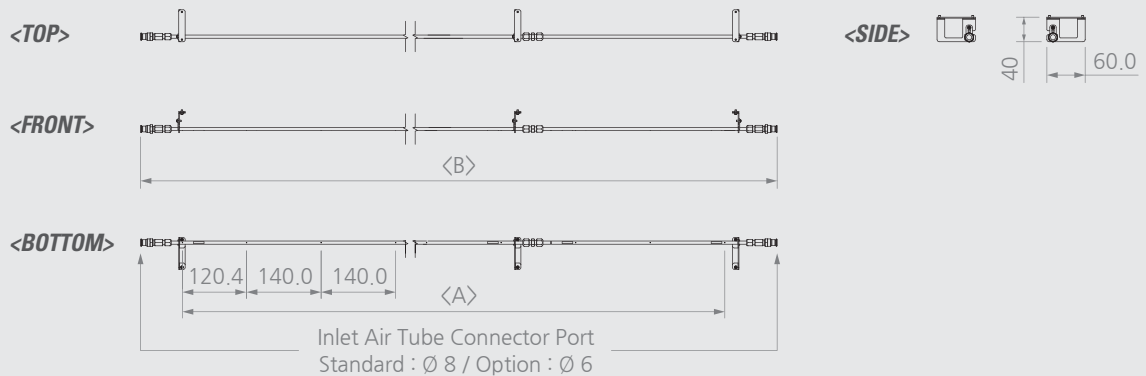
### Dimensions

#### ► SXB-05NRAA

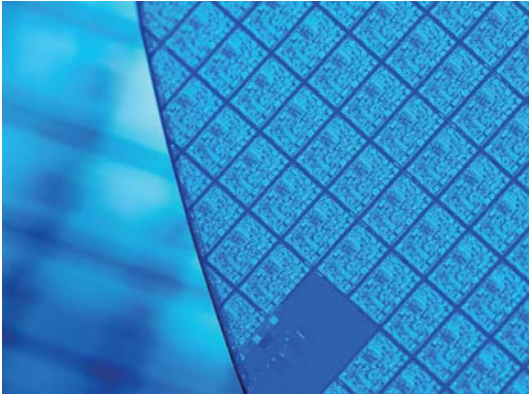


Model No.	A	B
SXB-05NRAA-300	291.4	446.5
SXB-05NRAA-600	602.4	757.5
SXB-05NRAA-900	913.4	1068.5
SXB-05NRAA-1200	1224.4	1379.5
SXB-05NRAA-1500	1535.4	1690.5
SXB-05NRAA-1800	1846.4	2001.5
SXB-05NRAA-2200	2157.4	2312.5
SXB-05NRAA-2500	2468.4	2623.5
SXB-05NRAA-2800	2779.4	2934.5

#### ► SXB-05NSRAA



Model No.	A	B
SXB-05NSRAA-700	680.4	857.5
SXB-05NSRAA-1100	1100.4	1277.5
SXB-05NSRAA-1500	1520.4	1697.5
SXB-05NSRAA-2000	1940.4	2117.5
SXB-05NSRAA-2400	2360.4	2537.5
SXB-05NSRAA-2800	2780.4	2957.5
SXB-05NSRAA-3200	3200.4	3377.5
SXB-05NSRAA-3600	3620.4	3797.5



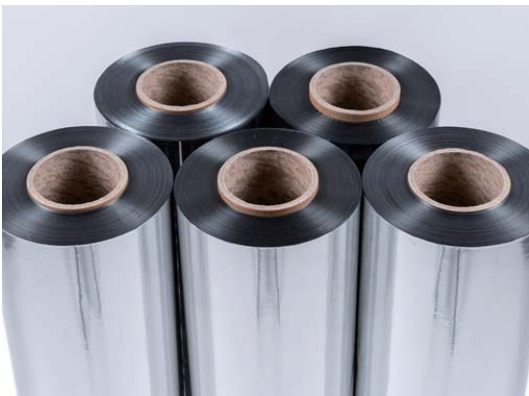
## Semiconductors

반도체의 소형화 및 회로 집적도 증가로 인해 반도체는 정전기에 더욱 취약해졌습니다. 정전기는 반도체 내부 회로를 손상, 파괴하거나 장치 결함을 유발하므로 정전기 제거는 필수입니다.



## Liquid crystal / Organic EL displays

액정 및 유기 EL 디스플레이의 크기와 해상도가 계속 증가하는 만큼 생산 공정에서도 많은 정전기 문제가 발생하고 있습니다. 더 넓어진 표면적에서 얼마만큼 빠르게 정전기를 제거하느냐는 생산 수율과 직결되는 부분이라 매우 중요한 요소입니다.



## Films

필름과 롤러의 압력과 마찰에 의해 발생하는 정전기는 불꽃을 발산하여 필름을 손상(천공)시키거나 이물질 부착, 후가공 시 작업 효율의 하락, 정전기 쇼크로 인한 안전 문제 등을 일으킵니다. 특히 권취 및 권출 시 수십만 kV의 정전기가 발생하는데 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 열악한 조건에서도 정전기를 중화시킬 수 있습니다.



## Plastic injection molding

플라스틱 사출 성형 시 마찰과 박리로 인해 많은 양의 정전기가 발생합니다. 이때 발생된 정전기는 사출성형기 내 이물질을 부착하게 해 불량률 유발하며 성형품이 금형에서 분리되지 않게 만들어 수시로 작업자가 분리해야 하는 공수 증가 등 생산 수율 및 효율을 악화시킵니다. 정전기 제거 장치를 사용하면 이러한 문제점을 해결할 수 있습니다.



## Powder

분말 입자들의 마찰로 인해 발생된 정전기는 분말 입자를 투입구 및 용기에 부착하게 만들어 균일한 양으로 포장하는 것을 방해해 생산 효율 및 수율 저하의 원인이 됩니다. 또한 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 광조사식 정전기 제거 장치는 분말 입자와 같이 공기 흐름이 없어야 하는 곳의 정전기 문제를 해결할 수 있습니다.



## Printing

종이와 필름에 대전된 정전기로 인해 잉크 번짐, 잉크 비산, 분말 도포 불균일, 용지 2장 이상, 용지 이송 중 부착, 용지 막힘, 용지 경렬 오류 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 순차적으로 진행되는 인쇄 공정상 한 공정에서라도 정전기 문제가 발생한다면 차후 공정에도 영향을 미쳐 시간·금전적인 손해가 일어날 수 있습니다.



## Rechargeable Batteries

이차 전지를 생산하기 위해서는 드라이 클린룸 및 습도가 낮은 환경은 필수입니다. 이러한 환경은 정전기가 발생하기 쉬우므로 정전기를 중화시키기 위한 대책이 필요합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 분리막 필름 손상(천공) 및 이물 부착을 방지해 제품 결함은 낮추고 수율은 높일 수 있습니다.



## Coating / Painting

코팅 / 도장은 금속 및 플라스틱 자동차 부품을 비롯한 수많은 응용 분야에서 활용됩니다. 코팅 / 도장 과정에서 발생하는 정전기는 재료가 번지거나 비산되는 원인이 될 수 있으며 이물을 부착시켜 품질을 저하할 수 있습니다. 또한 공정 특성상 다량의 가연성 가스를 포함하고 있어 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 문제를 방지하고 품질을 향상할 수 있습니다.